

# 2006 第四屆微電子技術發展與應用研討會

## 2006 Conference on Microelectronics Technology and Applications (2006 C'META)

研討主題：(一) 半導體材料組 (二) 半導體元件組 (三) 半導體封裝組  
(四) 系統設計組 (五) 訊號與系統組

指導單位：教育部、行政院國家科學委員會

主辦單位：國立高雄海洋科技大學、日月光半導體製造股份有限公司、  
高雄市南台灣產業科技推動協會

承辦單位：國立高雄海洋科技大學 微電子工程系

協辦單位：國立高雄海洋科技大學 研發處  
國立高雄海洋科技大學 海洋工程學院  
日月光文教基金會  
和春技術學院

敦揚科技股份有限公司

論  
文  
徵  
稿

會議地點：國立高雄海洋科技大學音樂廳 (高雄市楠梓區海專路 142 號)

會議時間：2006 年 5 月 19 日(星期五)

報名方式：2006 年 5 月 12 日前至網站完成線上報名作業 (於會議當日現場  
報名者，不備餐點)

論文投稿：論文摘要截稿日期: 2006 年 3 月 20 日(星期一)(含中英文摘要)

論文摘要審查結果通知日期: 2006 年 4 月 3 日(星期一)

論文全文截稿日期: 2006 年 4 月 14 日(星期五)(中、英文不拘)

(請至研討會網站登錄並上傳中英文摘要與論文全文)

研討會網站：<http://203.64.169.181/2006/index.htm>

聯絡方式：

葉旻彥 副教授 電話: (07) 3617141 轉 3354

張心怡 助理 電話: (07) 3617141 轉 3352

曾秋雯 助理 電話: (07) 3617141 轉 3364

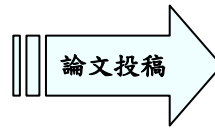
傳真: (07) 3645589

郵件: meta@mail.nkmu.edu.tw



## 論文邀稿

- 研討會時間：2006年5月19日(星期五)。
- 舉辦地點：國立高雄海洋科技大學音樂廳  
高雄市楠梓區海專路142號
- 論文摘要截稿日期：95年3月20日(星期一)。
- 論文全文截稿日期：95年4月14日(星期五)。
- 投稿中文格式：標楷體
- 投稿英文格式：Time New Roman



(download)

## 論文投稿須知

[中文論文格式](#)

1. 論文摘要截稿日期為95年3月20日，摘要需附中文及英文內容，(英文字型：Times New Roman，中文字型：標楷體)詳細格式請參考下列之格式或至研討會網站查閱。
2. 摘要審查接受函將於95年4月3日前發送。
3. 論文全文截稿日期為95年4月14日，中英文內容不拘，全文4-6頁。(英文字型：Times New Roman，中文字型：標楷體)。
4. 論文投稿請一律以 pdf 電子檔，至研討會上傳。
5. 選擇您希望投稿之主題：

半導體材料組

半導體元件組

半導體封裝組

系統設計組

訊號與系統組

4. Paper format (used font: Times New Roman)

**Title (字體大小為 14,粗體)**  
**Author (字體大小為 12)**  
**Affiliation of Author (字體大小為 12)**  
**E-mail address : xxx@xxx**

**Abstract (字體大小為 12)**

**Keyword (字體大小為 12)**

**Content (字體大小為 12)**

# 2006 微電子技術發展與應用研討會 徵稿主題

## 一、半導體材料：

1. 化合物半導體材料(Compound Semiconductor Materials)
2. 積體電路相關材料(ULSI Materials)
3. MOS Gate 氧化膜材料(MOSFET Gate Oxide Materials)
4. 半導體領域相關新材料(New Semiconductor Materials)
5. 生化半導體材料(Bio/Chemical Materials Combined with Semiconductor)

## 二、半導體元件：

1. 矽材半導體元件(Silicon-based semiconductor devices)
2. 化合物半導體元件(Compound semiconductor devices)
3. 微機電元件(MEMS devices)
4. 有機半導體元件(Organic semiconductor devices)
5. 電子陶瓷元件(Electronic ceramic devices)

## 三、半導體封裝組：

1. 半導體封裝技術( Semiconductor packaging technology)
2. 半導體封裝材料( Semiconductor packaging material)
3. 半導體封裝量測( Semiconductor packaging measurement)

## 四、系統設計組：

1. 系統晶片設計( System of chip)
2. 積體電路設計(VLSI Design)
3. 射頻電路設計(RF circuit design)

## 五、訊號與系統組：

1. 數位訊號處理( Digital signal processing)
2. 通訊理論與系統(Communication principles and systems)
3. 多媒體通訊(Multimedia communication)